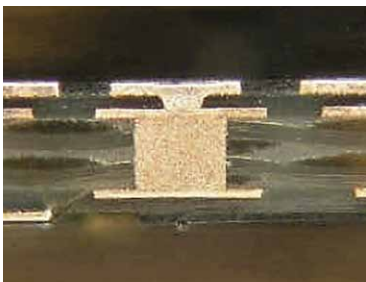
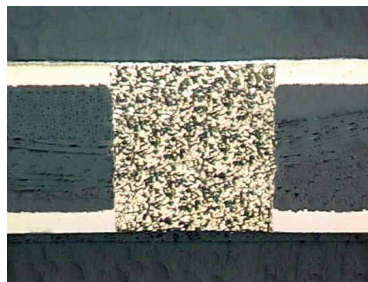


비도금 Via 용 도전성 홀 메움 Paste

DD Paste AE2217 / AE1244



1-2-1 Stack Via 형 Build Up Core 기판

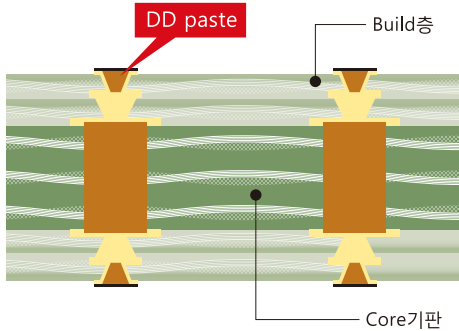


Ni/Au 도금 직접형성

특징

- ▶체적저항률 ($1.0 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$)
- ▶Voidless
- ▶평활성 우수
- ▶상부 도금의 신뢰성 우수

구조



물성·성질

	Long Life Grade AE2217	범용 Grade AE1244
금속분	Ag Coat Cu 분	Ag Coat Cu 분
수지	에폭시수지 (2액형)	에폭시수지
용제	무용제	무용제
점도 (BH형) (pa·s)	200	110
경화조건	가건조	40°C/30min+80°C/60min
	분경화	160°C/60min
체적저항률 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	1.0×10^{-4}	1.0×10^{-4}
Tg점 (DMA) (°C)	113	110
선팅창계수	$\alpha 1$ (ppm)	63
	$\alpha 2$ (ppm)	91
열전도율 (W/mk)	13.5	11.7
도금 Peel 강도	조화(粗化)없음(N/cm)	4.5
		4.8

가공 프로세스



장기신뢰성

	Long Life Grade AE2217		범용 Grade AE1244	
항목 (FR-4, 1.0mmt, 0.35mm ϕ)	상부도금 박리·들뜸	도통저항 (m Ω /穴)	상부도금 박리·들뜸	도통저항 (m Ω /穴)
초기	없음	15	없음	15
Solder내열성 (288°C/10sec/3cycles)	없음	13	없음	13
열충격성 (-65°C/30min \leftrightarrow 125°C/30min/1000cycles)	없음	8	없음	8
PCT (121°C/2atm/100%RH/336h)	없음	8	없음	8

※참고치이며 보증치는 아닙니다.